




TRESKY T-6000-L FLEXIBLE AUTOMATIC DIE BONDER

La die bonder T-6000-L è un sistema universale completamente automatizzato indicato per produzioni di medie dimensioni, linee pilota e per attività di ricerca e sviluppo. È dotato di motori lineari con risoluzione 0,1 µm, ciò consente una precisione di movimento di 8 µm @ 3 Sigma. Una gamma di forza da 15 g fino a 800 g, combinata ad un'ampia area di lavoro di 495 mm x 400 mm e la movimentazione di wafer fino a 8", offre una vasta gamma di applicazioni. Con numerose opzioni disponibili, il T-6000-L può essere personalizzato per soddisfare al meglio tutte le esigenze del mercato.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA TRESKY T-6000 L SONO:

- area di lavoro 495 mm x 400 mm
- movimento XY del supporto del wafer 220 mm x 220 mm
- movimento dell'asse Z di 100 mm
- rotazione dello spindle 200°
- standard range della Bond Force da 15g a 800g
- UPH 2000
- precisione di piazzamento 8 µm @ 3 Sigma
- risoluzione assi XYZ di 0.1µ
- risoluzione asse Theta di 0.02u
- dimensioni dei componenti da 100 mm fino a 20 mm
- wafer pickup da 2" fino a 8"

INOLTRE CON LE VARIE OPZIONI DISPONIBILI È POSSIBILE:

- estendere il range della Bond Force fino ad oltre 5000 g
- utilizzare un tool riscaldabile ma che limita la rotazione dello spindle a 100°

ELEXIND S.p.A.

Via A. Erba 35/37 - 20066 Melzo (MI) - Italy - T. +39 02.92.72.15.1 r.a. - F. +39 02.92.10.33.89
info@elexind.it

© Elexind S.p.A. - Tutti i marchi e le immagini appartengono ai legittimi proprietari.

www.elexind.it 